

No.: 201-03-1289

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION

6214series

0.5mm PITCH FPC/FFC CONNECTOR

京セラ株式会社 KYOCERA Corporation

В	DCN22231	2022/04/26	N. Kitagawa		A. Tsunemura
Α	DCN21089	2021/02/09	A. Murata	N. Kitagawa	M. Yoshida
0	EDN19191	2019/08/05	B. Murata	N. Kitagawa	Y. Fujii
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

- 1. 品名 FPC/FFC CONNECTOR (鉛フリー品 LEAD-FREE PRODUCT)
- 2. 形式 0.5mm PITCH FPC/FFC CONNECTOR
- 3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 6214 シリーズ 0.5mm ピッチコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies 6214 Series 0.5mm pitch FPC/FFC connector.

- 4. 関連規格 Related documentation
 - ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

-JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

- -JIS C 5402:1992 電子機器用コネクタの試験法 Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.
- 5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material 図面参照 Refer to drawings.

製品型番 Part numbering



仕様 Spec

嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件·方法 Condition	規格 Specification
7.一般	1	定格電流	-	DC 0.4A/contact
General		Current rating		
	2	定格電圧	_	DC 50V/contact
		Voltage rating		
	3	使用温湿度範囲	_	-40°C ~ 85°C 95% RH MAX.
		Operation environment		低温に於いて氷結ないこと。
				結露しないこと。
				通電による温度上昇分も含む。
				Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
				Including terminal temperature rise.
	4	保存温湿度範囲	梱包状態にて	-20°C ∼ 60°C 60% RH MAX.
		Storage environment	While packed	低温に於いて氷結ないこと。
				結露しないこと。
				Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
8.機械的	1	外観	目視	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形
Mechanical		Appearance	Visual inspection	等のないこと。
				No rust, contamination, damage
				or deformation harming functions.
	2	スライダー挿入力	25mm/min. / 10 times	1.19N/pin MAX.
		Slider insertion force		
	3	スライダー抜去力	25mm/min. / 10 times	0.19~1.19N/pin
		Slider separation force		
	4	コンタクト保持カ	25mm/min.	4N MIN.
		Contact retention force		
	5	FPC/FFC 保持力	25mm/min.	0.3N/pin MIN.
		FPC/FFC retention force		
	6	挿抜耐久性	無通電状態で	接触抵抗 Contact resistance
		Durability	Without current applied	100mΩ MAX.
			10 times/min. / 10 times	
	7	振動	10∼55∼10Hz/min.	瞬断 Discontinuity
		Vibration	/ 1.5mm (peak to peak)	1 μ s MAX.
			✓ DC 100mA	外観 Appearance
			(2h per direction; XYZ, 6h in total)	機械的破損、部品のゆるみクラック
			IEC 60068-2-6:1995	等ないこと。
			JIS C 60068-2-6:1999	No damage, loose part or crack.
				接触抵抗 Contact resistance
	_	徒 - 庫公	500 / 11	100mΩ MAX.
	8	衝撃	50G / 11ms	瞬断 Discontinuity
		Shock	/ DC 100mA	1 μs MAX.
			(3 times per direction; XYZ)	外観 Appearance
			IEC 60068-2-27:1972	機械的破損、部品のゆるみクラック
			JIS C 60068-2-27:1995	等ないこと。 Na damana lagan part ay ayaal
				No damage, loose part or crack.

6214 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-1289

9			1.1.1 4 "/1.144		\=\± +n = _
Clead-free solder FSn-3Ag-0.5Cul Sign-3Ag-0.5Cul Sign-3A		9	はんだ付性	$245\pm3^{\circ}$ C $/$ 3 $_{-1}^{0}$ sec.	浸漬部にはんだが 95%以上
『Sm-3Ag-0.5Cu』 JIS C 60068-2-20:1996 ※取り扱い注意事項 7 参照 Refer to precaution 7 10 はん定耐熱性 Resistance to solder heat			_	immersion	
**取り扱い注意事項 7 参照 Refer to precaution 7 10 はんだ耐熱性 Resistance to solder heat 《Lead-free solder》 『Sm-3Ag-0.5Cu』 『Sm-3Ag-0.5Cu』 『Sm 2Ag-0.5Cu』			"	IEC 60068-2-20:1979	shall be covered with solder.
Refer to precaution 7 10 はた耐熱性 Resistance to solder heat (Lead-free solder) 『Sn-3Ag-0.5Cu』			[Sn-3Ag-0.5Cu』	JIS C 60068-2-20:1996	
#照 Refer to precaution 7					
Refer to precaution 7 10 はんだ可熱性性 Resistance to solder heat (Lead-free solder) 『Sm-3Ag-0.5Cu』 Bit temperature 350±10°C 3 ** sec. IEC 60088-2-20:1996 ペリフロー Reflow			※取り扱い注意事項 7		
はんだ耐熱性 Resistance to solder heat (Lead-free solder) ISn-3Ag-0.5Cu』 IEC 60088-2-20:1979 ISC 60068-2-20:1979 ISC 60068-2-20:1976 ISC 60068-2-36:1999 ISC 60068-2-58:2002 ISC 60068-2			参照		
はんだ耐熱性 Resistance to solder heat (Lead-free solder) ISn-3Ag-0.5Cu』 IEC 60088-2-20:1979 ISC 60068-2-20:1979 ISC 60068-2-20:1976 ISC 60068-2-36:1999 ISC 60068-2-58:2002 ISC 60068-2			Refer to precaution 7		
Resistance to solder heat 《Lead-free solder》 『Sn-3Ag-0.5Cu』 はんだこで温度 Bit temperature 《Lead-free solder》 『Sn-3Ag-0.5Cu』 『EC 60068-2-20:1979 』 『Sn-3Ag-0.5Cu』 『EC 60068-2-20:1979 』 『Sn-3Ag-0.5Cu』 『EC 60068-2-20:1998 〈リフロー Reflow〉 下記プロファイル参照 Refer to precaution 7 Pall		10	•	<手はんだ Hand soldering>	端子ガタ 変形等ないこと。
Bit temperature 350±10°C 3 % sec. IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996 <リプロー Reflow〉 下記プロアルや解 Set the following condition リプローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネク表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK AC 200V、Imin. (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992 総縁抵抗 Insulation resistance 3 ローレバル接触抵抗 Low level Bit temperature 350±10°C 3 % sec. IEC 60068-2-20:1996 < リプロー Reflow〉 下記プロアルや参照 Sec the following condition リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネク表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK 7フラッシュオーバー、スパーウオーバー 及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown. JIS C 5402 (5.1):1992 認解しているの解し、 初期 Initial: 1000M Ω MIN. Istikie After test: 100M Ω MIN. Istikie After test: 100M Ω MIN. DOW PRE HEAT TIME(s) 7フラッシュオーバー、スパーウォーバー のでは自転では、ロッシュスが、のでは、ロッシュスが、					
(Lead-free solder) 『Sn-3Ag-0.5Cu』					No loose contacts not deformation.
FSn-3Ag-0.5CuJ					
※取り扱い注意事項 7				•	
***********************************			Sn−3Ag−0.5Cu.	IEC 60068-2-20:1979	
下記プロファイル参照 See the following condition リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage AC 200V、 Imin. (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992 2 絶縁抵抗 Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 2 絶縁抵抗 Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 3 ローレベル接触抵抗 Down Processing MAX. FRIED TOWN Process				JIS C 60068-2-20:1996	
Refer to precaution 7 See the following condition リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage AC 200V、 Imin. (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992 2 絶縁抵抗 Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 30±10 s 7ラッシュオーバー、スパークオーバー 及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown. 3 ローレベル接触抵抗 DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 3 回ーレベル接触抵抗 DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 3 回場 Nimital 1:1000M			※取り扱い注意事項 7	<リフロー Reflow>	
リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK			参照	下記プロファイル参照	
リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネク表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58: 1999 JIS C 60068-2-58: 2002 JIS C 60068-2-58: 2002 PEAK			Refer to precaution 7	See the following condition	
Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK PEAK 250°C 1				_	
※但し、2回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK				• • • •	
Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 9.電気的 Electrical 1 耐電圧 Dielectric (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992 Modiant process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK 250 9.電気的 Electrical 1 耐電圧 (Leak 2mA)					
be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 9.電気的 Electrical 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage JIS C 5402 (5.1):1992 No flashover, spark over nor dielectric breakdown. 2 絶縁抵抗 Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 試験後 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 Isting & After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 Isting & After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 Isting & After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 Isting & After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 Isting & After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 対象 After test:100M \(\Omega\$ MIN. Insulation resistance					
product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 9.電気的 Electrical 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage 2 絶縁抵抗 Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 Low level 3 ローレベル接触抵抗 Low level					
down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK					
プーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK					
(コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK 250 30±10s PRE HEAT TIME(s) AC 200V、 1min. (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992 2 絶縁抵抗 DC 500V、 1min. Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 DC 500V、 1min. Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 Low level 50mΩ MAX.					
(On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK PEAK PEAK 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage AC 200V、1min. (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992 総縁抵抗 Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 Low level (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 PEAK PEAK TIME(s) 7ラッシュオーバー、スパークオーバー 及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown. 初期 Initial:1000M Min. 試験後 After test:100M Min. 試験後 After test:100M Min. Four prove method				_ :	
Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002 PEAK				(コネクタ表面)	
JIS C 60068-2-58:2002 PEAK 250 PEAK 250 PEAK 250 PRE HEAT TIME(s) PRE HEAT				(On the surface connector)	
9.電気的 Electrical 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage JIS C 5402 (5.1): 1992				(Modified) IEC 60068-2-58:1999	
9.電気的 Electrical 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage 2 絶縁抵抗 Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 Low level 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage 1 耐電圧 Dielectric (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992 DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 対験 After test :100M Ω MIN. Tour prove method 1 耐電圧 Dielectric (Leak 2mA) DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 対験 After test :100M Ω MIN. Tour prove method				JIS C 60068-2-58:2002	
9.電気的 Electrical 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage 2 絶縁抵抗 Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 Low level 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage 1 回過子法にて Four prove method 2 を 200V、 1min.				0	
9.電気的 Electrical 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage 2 絶縁抵抗 Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 Low level 1 耐電圧 Dielectric withstanding voltage 1 耐電圧 Dielectric (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992 DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 対験 After test :100M Ω MIN. Tour prove method 1 耐電圧 Dielectric (Leak 2mA) DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 対験 After test :100M Ω MIN. Tour prove method				У Т. 350	PEAK
TIME(s) 9.電気的 Electrical 1 耐電圧				₩ 250 X 230	
TIME(s) 9.電気的 Electrical 1 耐電圧				出 出 180 ···································	
TIME(s) 9.電気的 Electrical 1 耐電圧				F 100	30+10 s
TIME(s) 9.電気的 Electrical 1 耐電圧				Ö 150	
TIME(s) 9.電気的 Electrical 1 耐電圧				<u>0</u>	
9.電気的 Electrical 1 耐電圧 Dielectric (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992 2 絶縁抵抗 Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 Low level AC 200V、 1min. (Leak 2mA) DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 AC 200V、 1min. 及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown. 初期 Initial :1000MΩ MIN. 試験後 After test :100MΩ MIN. 50mΩ MAX.				PRE F	1EA I
ElectricalDielectric withstanding voltage(Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.2絶縁抵抗 Insulation resistanceDC 500V、1min. JIS C 5402 (5.2):1992初期 Initial :1000MΩ MIN. 試験後 After test :100MΩ MIN.3ローレベル接触抵抗 Low level四端子法にて Four prove method50mΩ MAX.					TIME(s)
ElectricalDielectric withstanding voltage(Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.2絶縁抵抗 Insulation resistanceDC 500V、1min. JIS C 5402 (5.2):1992初期 Initial :1000MΩ MIN. 試験後 After test :100MΩ MIN.3ローレベル接触抵抗 Low level四端子法にて Four prove method50mΩ MAX.	9.電気的	1	耐電圧	AC 200V、 1min.	フラッシュオーバー、スパークオーバー
withstanding voltage JIS C 5402 (5.1):1992 No flashover, spark over nor dielectric breakdown. 2 絶縁抵抗 Insulation resistance 3 ローレベル接触抵抗 Low level DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 対験後 After test :100MΩ MIN. 50mΩ MAX.			• • • •	•	
dielectric breakdown. 2 絶縁抵抗 DC 500V、1min. 初期 Initial :1000MΩ MIN. 試験後 After test :100MΩ MIN. 3 ローレベル接触抵抗 四端子法にて 50mΩ MAX.					
2 絶縁抵抗 DC 500V、1min. 初期 Initial :1000MΩ MIN. is is is it					-
Insulation resistance JIS C 5402 (5.2):1992 試験後 After test :100MΩ MIN. 3 ローレベル接触抵抗 四端子法にて 50mΩ MAX. Four prove method		2		DC 500V. 1min	
3 ローレベル接触抵抗 四端子法にて 50mΩ MAX. Low level Four prove method		_			
Low level Four prove method		2			
		٥			OUITE WAY.
contact resistance				•	
					ウルボケス
4 │ 温度上昇 │ 嵌合状態でコンタクトを直列に結線 │ 定格電流にて		4			
Temperature rise Under mated condition, At the current rating			I Lemperature rise	Under mated condition,	_
in series.				all contacts shall be connected	30K MAX.
JIS C 5402 (5.10): 1992				in series.	30K MAX.

6214	SERIES	PRODUCT	SPECIF	I CAT I ON
$U \angle I \rightarrow$	011110	1 11(1)(1)(1)(1)	oi i o i i	1 (74) 1 1 (71)

10.耐環境	1	硫化水素	40±2°C ∕ 75% RH		4	接触抵抗 Contact resistance
Environment	Ι΄.	H ₂ S	/ 3±1ppm / 240h IEC 60068-2-43:1976 JIS C 60068-2-43:1993			100m Ω MAX.
Liviloilileit		1120				TOOM IE WIN OX.
	2	塩水噴霧		eight% / 35:		外観 Appearance
	_	塩水噴霧 Salt mist	✓ 48h	_	±2 C	著しい腐食が生じないこと。
		Sait Illist		' 068–2–11 : 198	1	有 0 い
				60068-2-11:19		No evident corrosion.
	3	温度サイクル	5 cycle	es		接触抵抗 Contact resistance
		Temperature cycling	(Modifi	ed) IEC 60068	-2-14:1984,	100mΩ MAX.
					-33:1971	
			JIS C	0025 : 1988		
			段階	温度(℃)	時間(分)	
			Step	Temperature	Time(min.)	
			1	-40±3	30	
			2	$25\pm\frac{10}{5}$	5 MAX.	
			3	85±2	30	
			4	$25\pm {}^{10}_{5}$	5 MAX.	
	4	湿度	JIS C 60068-2-3:1987		絶縁抵抗 Insulation resistance	
		Moisture resistance			100MΩ MIN.	
					87	接触抵抗 Contact resistance
						100mΩ MAX.
						耐電圧
						Dielectric withstanding voltage
						フラッシュオーバー、スパークオー
						バー及び絶縁破壊等がないこと。
						No flashover, spark over nor
						dielectric breakdown.
	5	高温加速(寿命)	85±2°C ∕ 96h			接触抵抗 Contact resistance
		High temperature (Life)		068-2-2:1974		100mΩ MAX.
				60068-2-2:19	95	
	6	耐寒性		3°C ∕ 48h		接触抵抗 Contact resistance
		Cold resistance	IEC 60068-2-1:1990			100m Ω MAX.
			JIS C	60068-2-1:19	95	

取り扱い注意事項 Precautions

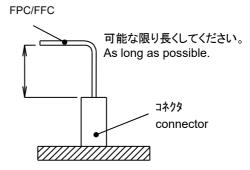
1 FPC/FFC の屈曲について Flexion of FPC/FFC

FPC/FFC の屈曲によりコネクタ接点部に過剰な負荷がかからないようにご注意願います。 尚、FPC/FFC をコネクタのカード挿入口近くで繰り返し屈曲させ使用する場合は、ご相談ください。 条件によっては弊社にて評価確認を行います。

Pay attention not to apply an excess load to contacts of the connector because of the flexion of FPC/FFC.

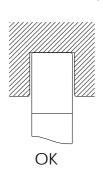
Please contact us when your FPC/FFC have to be bent repeatedly near the opening for card insertion.

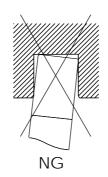
Depending on conditions, evaluation and verification shall be conducted by us.

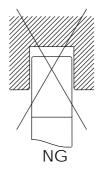


2 FPC/FFC の挿入について FPC/FFC insertion and separation

FPC/FFC はカードスロット底面に当てられるまで垂直に挿入して下さい。 Insert the FPC/FFC vertically until it hits to the slot end.





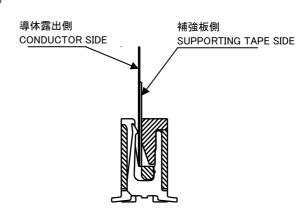


検査工程等で FPC/FFC の挿抜を行う際は、最終組み込み用 FPC/FFC よりも薄い FPC/FFC を使用願います。

For the FPC/FFC insertion and separation in the inspection process, please use thinner FPC/FFC than those for final assembling.

3 FPC/FFC の方向性 Direction of FPC/FFC

図のように補強板がスライダー側になるように装着して下さい。 FPC/FFC shall be inserted as shown below with supporting tape side slider.



6214 SERIES PRODUCT SPECIFICATION

No. 201-03-1289

4 スライダー操作 Slider operation

コネクタの破損防止の為、スライダー操作は基板に半田付け後行うようにして下さい。 After soldering, a slider shall be operated to prevent damage to a connector.

5 実装について Mounting

本製品は低背、省面積化を実現する為、インシュレータが非常に薄肉になっております。 従いまして、FPC 基板へのマウント等実装条件につきましては弊社と打合わせの上、確認して頂きますよう お願い致します。

また、FPC 実装の場合 FPC のたわみにより半田クラックなどが発生する可能性があります。

この為、実装部にはできるだけ厚い(少なくとも 0.3 mm 以上)補強板を貼り付けることを推奨します。

尚、本製品の実装エリア(投影エリア)へのシルク印刷は、コネクタ本体がシルク印刷上に乗り上げ、実装不良等の 原因となることがある為、避けて頂きますようご配慮願います。

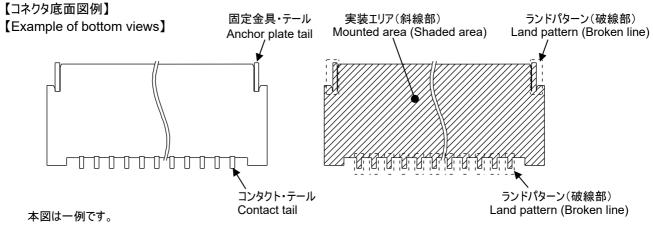
リフロー加熱によりスライダー外表部にふくれが発生する場合がありますが、FPC/FFC の挿入及びコンタクトの可動を妨げるものではなく、実使用上問題はありません。

Thin molding insulators realize the low-profile and small space character of this product.

Mounting conditions on FPC boards, therefore, need to be consulted with us and confirmed.

When an FPC board is connected, deflection in bending the FPC board may cause a solder crack. In order to prevent it, it is suggested to attach a reinforcing plate that has 0.3 mm or more in thickness to the connecting area on the FPC board.

It shall be prohibited to apply silkscreen printing to the area on the board where this connector is mounted, because the connector running on the silkscreen printing may cause a mounting failure. Although blisters may be formed on molding sliders due to the reflow heat, it will not interfere with the movability of contacts, so there is no practical problem.



本製品の実装エリア(投影エリア)につきましては図面を御確認下さい。

The figure above is an example.

Please refer to the drawing for the mounted area of this product.

6 活線挿抜について Hot Swap

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさらないよう御願い致します。 Insertion and separation under live current shall not be done.

7 はんだについて Solder

本製品は、鉛フリーはんだ Sn-3Ag-0.5Cu の使用を推奨しております。推奨はんだ以外の使用については御相談下さい。

Lead-free solder Sn-3Ag-Cu is recommended to be used with this connector.

Please consult us if your solder is different from the ones of our recommendation.

6214	SFRIFS	PRODUCT	SPECIE	ICATION
U/ I→	.) \ \	1 111/11/11/11	011111	

特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

(1)本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、 本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、 貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2)本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。 If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive
- (3)以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

products, or replace or repair defective products.

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

- 1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の条件が加わった事が証明された場合。
 - If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to vou.
- 2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品 の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛 Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.